



华人芯片设计技术研讨会

学生海报 CALL FOR POSTER



线下举办时间 2023年3月22日
18:30-21:00
申请截止日期 2023年2月10日

学生海报环节 Student Poster Session

为了进一步鼓励芯片设计领域的同学交流，ICAC 2023在学者主题演讲外，还设置了学生海报环节，并鼓励大家进行实物展示。在这一环节，芯片设计领域的研究生们将获得：

- ★ 直接向学术界、行业专家展示工作的机会
- ★ 相近领域不同学校间的同学联系网络，增强感情
- ★ 交流高水平论文的投稿心得，共同进步
- ★ 会议注册费豁免

海报形式与要求 Poster Submission

与大会正式环节相同，学生海报要求展示已在芯片设计领域高水平期刊和会议中录用的论文。这些期刊和会议包括但不限于：ISSCC/VLSI/ASSCC/CICC/ESSCIRC/RFIC、IEEE Journal/Trans等。绝大多数情况下，要求海报对应的论文已经具备流片测试结果并体现出领先的性能，但是特别优秀的其他结果形式也在考虑范围。海报内容允许和大会正式演讲环节的内容重叠。

申请人须在2月10日前提交海报论文的基本信息。经评审录用后，须在3月10日前提交海报最终版本。ICAC 2023举办时，组委会将统一印刷海报，海报作者须提前抵达现场进行展览布置。

最佳学生海报奖 Best Student Poster Award

ICAC海报环节将评比出最佳学生海报奖，并在大会进行颁奖

投稿方式 Submission Method

请通过下列表单链接进行投稿

<https://iconf.young.ac.cn/6qFq9>

或

扫描二维
码投稿



联系人 Contacts

学生海报环节主席：陈迟晓 cxchen@fudan.edu.cn

主办单位



东南大学
SOUTHEAST UNIVERSITY



复旦大学
FUDAN UNIVERSITY



澳门大学
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU



电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China



清华大学
Tsinghua University

支持单位

深圳福田区人民政府

河套深港科创合作区

承办单位

华芯集成电路技术中心